

## 未來計劃及[編纂]

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 我們的策略」。

### [編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股H股[編纂]港元(即於本文件所述的最高[編纂])，我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、費用和估計開支後，我們將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]港元。

根據我們的策略，我們目前擬於未來五年內將該等[編纂]用作以下用途(視乎業務需要演變及市場狀況變化而作出變動)：

- 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將用於為下一代產品研發提供資金。具體而言：
  - (i) 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將用於高端半導體AI芯片最終測試探針的研發。我們主要擬分配該[編纂]於以下三個領域的研發資金：(a)探針尖端超硬導電材料，包括開發維氏硬度目標值不低於HV850、接觸電阻不高於 $5\text{m}\Omega$ 且低磨損率的納米塗層堆疊鎢錒合金；(b)微間距順應式探針結構，採用懸浮式雙接觸架構，可兼容最小 $20\ \mu\text{m}$ 針距並實現單點測試壽命最高達500,000次觸地；及(c)高頻信號完整性優化，採用阻抗匹配設計與集成屏蔽技術以支持112Gbps、PAM4傳輸，同時降低串擾；

該投資將包括硬件設備及軟件系統。我們計劃購置：(i) 8台研發設備，以提升我們的MEMS微納米製造設計及原型製作能力；(ii) 13套監控設備(按估計成本)，以提升我們的半導體測試探針性能驗證及質量控制能力；(iii) 7套激光鑽孔設備，以提升微加工精度及微型傳動系統元件製造；及(iv) 4套自動化組裝設備，以優化探針卡組裝效率及製造良率。我們計劃採購：(i) 9份模擬軟件授權，以加速用於微型傳動系統的MEMS結構設計及電磁模擬；及(ii) 7份仿真軟件授權，以提升實體原型之前的設備建模、機械應力分析及電氣性能預測能力。該等設備及軟體投資將強化我們的研發基礎設施，縮短新型MEMS誰被及半導體測試解決方案的開發週期時間，改善產品性能驗證，並支持我們針對先進封裝、高頻測試及微型傳動應用的下一代產品管線。

- (ii) 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將用於柔軟可彎曲探針技術及測試插座的研發。我們擬分配該[編纂]於以下領域的研發資金：(a)高延展性導電彈性體材料，包括開發含有銀納米線的硅基複合材料，目標為實現至少300%的斷裂伸長率及不高於 $0.1\ \Omega/\text{cm}$ 的線性電阻，同時兼具機械順應性與導電性；(b)微陣列可彎曲探針結構，採用仿生順應性接觸結構設計，以實現不高於5%的接觸壓力變化及每個測試點超過100,000次觸地的測試壽命；及(c)高頻干擾抑制與信號完

## 未來計劃及[編纂]

整性優化，包括優化屏蔽層及阻抗匹配架構以支持5G及毫米波頻段測試，同時降低插入損耗；及

我們擬購置：(i) 2套探針研發設備，以提升我們半導體測試探針的設計、原型製作及性能優化能力；(ii) 15件／套測試插座，以擴充我們的探針卡測試能力，並實現對不同半導體元件的全面電氣性能驗證；及(iii) 8套無塵室建設及設備，以建立符合MEMS微納米製程嚴格污染控制要求的受控製造環境。我們計劃採購三份軟件授權，以支持探針設計模擬、電機械建模及測試數據分析，以加速開發週期，並提升實體原型之前的探針性能預測。

- (iii) 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將用於GPU芯片熱管理解決方案的研發，包括散熱器及其他冷卻模組。我們擬分配部分[編纂]於以下領域的研發資金：(i) 微通道均熱板，推進微通道均熱板技術以提升有效傳熱能力；(ii) 兩相浸沒式液冷，開發用於高密度GPU集群的相變介電液浸沒解決方案，透過採用密封結構設計最大限度降低洩漏風險，目標為降低冷卻功耗超過40%；及(iii) 智能溫控算法，整合實時GPU功率及溫度遙測數據以動態調節冷卻能力並提供按需冷卻。分配至此項目的[編纂]預計將用於專業熱測試及測量設備以及原型開發設施，其餘部分將用於關鍵材料採購以及系統驗證及認證成本。
- 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將投資於招聘更多專業人士及擴充我們的人才庫。具體而言：
  - (i) 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將分配用於擴充研發團隊。我們預期將為MEMS微米及納米製造組件開發團隊增聘約80名工程師及科學家，為半導體測試探針開發團隊增聘約50名人員，以及為微型傳輸系統開發團隊增聘約20名人員；及
  - (ii) 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將分配用於擴充我們的銷售及營銷團隊。我們計劃在未來三年內增聘70名銷售及營銷人員，包括16名售後服務人員、22名品牌營銷人員及32名市場推廣人員。
- 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將分配用於本行業及價值鏈下游進行選擇性公司收購。我們目前預期物色一至兩個目標，其年收入約為人民幣50百萬元至人民幣150百萬元，價值各約人民幣100百萬元，據此我們將尋求收購少數股權（視乎估值、盡職調查及交易結構而定）。潛在收購目標預期將在與超精密級微納米製造相關的技術領域運營，特別是MEMS技術所代表的工藝平台及其衍生應用領域，如生物針頭及其他微結構設備解決方案。我們擬專注於具備微納米級專業製造能力、獨特工藝技術，或擁有能與我們現有技術優勢互補的專有技術的公司。除應用層面的機會外，我們亦將有選擇性地評估參與微納米製造工藝中關鍵先進功能性材料的上游材料供應商。就下游而言，我們旨在與具備系統整合能力的企業合作或對其

## 未來計劃及[編纂]

投資，以實現有關精密工程元件的有效商業化及工業規模部署。任何該等收購須符合慣常條件，包括令人滿意的盡職調查、正式協議、監管批准及董事會批准，並可能以[編纂]、內部資源及／或外部融資組合融資。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何具體收購目標或訂立任何正式協議，且無法保證任何收購將按本文所述條款完成或根本無法完成。

- 約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將分配用於升級及擴充我們於國內外的營銷及分銷網絡，以加強我們的全球佈局及銷售執行能力。此類分配預計將用於加強我們的市場推廣工作，包括參與行業展會及會議、品牌推廣及廣告活動，以及製作營銷材料，以提升我們在主要國內外市場的品牌知名度。我們還計劃通過建立及升級區域服務及維修中心、客戶支持設施及授權服務網點，加強我們的銷售渠道基礎設施及售後服務網絡，以提高客戶響應速度及服務質量。此外，我們擬通過設立倉庫設施、陳列室及相關物流安排，在特定市場擴展我們的本地化支持能力，並投資於數字營銷及客戶獲取計劃，以提高銷售轉化效率。通過這些措施，我們旨在增強市場滲透率，加強客戶參與度，並支持我們下一代產品在國內外市場的商業化。
- 餘下約[編纂]%的[編纂]或約[編纂]港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂][編纂]高於或低於預期（包括由於(i)[編纂]定價於低於最高[編纂]；或(ii)行使[編纂]所產生的額外[編纂]），我們將按比例調整上述用途的[編纂]分配。

倘我們的開發計劃中任何部分因政府政策變動導致我們任何項目的開發不可行，或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]。

倘[編纂]不足以資助上述用途，我們擬透過多種方式（包括運營所得現金、銀行貸款及其他借款）為差額提供資金。倘[編纂]未即時應用於以上用途，且在相關法律法規允許的範圍內，未動用[編纂]將僅會存放於持牌商業銀行及／或其他授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律法規）的短期計息賬戶。倘上述擬定[編纂]出現任何變動，我們將作出相應公告。